

证券代码：002185

证券简称：华天科技

## 天水华天科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>活动参与人员</b>	兴证全球基金管理有限公司 张传杰 公司接待人员：副总经理及董事会秘书常文瑛 证券部部长许腾旭
<b>时间</b>	2023年12月21日下午
<b>地点</b>	公司子公司华天科技（西安）有限公司
<b>形式</b>	现场交流
<b>交流内容及具体问答记录</b>	<p>交流内容主要如下：</p> <p>1、公司目前主要生产基地及经营情况</p> <p>公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关以及 Unisem。天水基地以引线框架类产品为主，产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NOR Flash 等。西安基地以基板类和 QFN、DFN 产品为主，产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。南京基地以存储器、MEMS 等集成电路产品的封装测试为主，涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列。昆山基地为封装晶圆级产品，主要产品包括 TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out 等。韶关基地以引线框架类封装产品、显示器件和显示模组产品为主。Unisem 封装产品包括引线框架类、基板类以及晶圆级产品，主要以射频类产品为主。目前公司在建的基地有华天科技（江苏）有限公司、上海华天集成电路有限公司。</p> <p>集成电路行业从 2022 年开始进入下行调整周期，并在 2023 年一季度形成低谷，二季度以来，市场逐步缓慢恢复，从公司经营来看，2023 年以来，收入规模逐季向好。</p> <p>2、未来行业发展趋势</p>

全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济和下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。近年来，在政策支持、市场需求及资本推动等因素合力下，我国半导体产业规模快速增长，占全球市场的比重持续提高。消费电子、高速发展的计算机和网络通信等市场应用已成为我国集成电路的主要应用领域，随着智能手机、平板电脑等消费电子的升级换代，以及传统产业的转型升级，汽车电子、安防、人工智能等应用场景的持续拓展，将持续拉动对集成电路的旺盛需求。

在我国集成电路产业链中，封装测试产业已经成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节，有望率先实现全面国产替代。

随着国内封装测试企业在 BGA、FC、WLCSP、Bumping、TSV、SiP、FO 等先进封装领域布局完善和先进封装产能持续释放，以及并购整合的持续进行，国内企业有能力承接全球集成电路封装业务转移，市场规模和市场集中度有望进一步提升。

### 3、公司最近推出的股权激励情况

公司此次股权激励计划是公司上市以来，第一次推出股权激励。本次的股权激励计划已经公司董事会、监事会审议通过，并完成内部公示，将于下周召开股东大会审议。封装测试企业是人员密集型企业，经过 20 年发展，公司员工总数已超过 2 万人，单靠工资薪金已经不能满足公司发展需要，通过股权激励的实施可以有效补充薪酬模式，可以吸引和留住优秀人才。公司希望通过股权激励计划的实施，调动激励对象的积极性，提升激励对象的工作热情，稳定员工队伍。

公司本次股权激励采取股票期权方式，拟向激励对象授予 25,000 万份股票期权，其中，首次授予 23,528 万份，预留 1,472 万份。首次授予的激励对象人数为 2,780 人，激励对象范围为公司及全资子公司、控股子公司的核心技术人员、核心业务人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包含公

	<p>司董事、高级管理人员以及不得作为激励对象的公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。</p> <p>4、公司在南京设立盘古公司的情况</p> <p>盘古公司是公司子公司华天科技（江苏）有限公司与公司董事肖智轶等相关方，各方拟共同出资 1 亿元，其中，江苏公司出资 6000 万元，持股比例 60%。目前，盘古公司尚未设立。</p> <p>盘古公司主营业务拟定为板级集成电路封装测试，与公司同属集成电路封装测试行业。板级封装是一种新的集成电路先进封装技术，它是将芯片再分布在矩形载板上，然后采用扇出工艺进行封装。与晶圆级封装相比，板级封装可以降低封装成本、提高材料利用率和封装效率。盘古公司设立以后，公司计划由肖智轶作为主要管理者，肖智轶作为公司先进封装业务核心人员，已有 20 多年先进封装领域研发和管理经验，在业内享有很高的知名度。</p> <p>5、大股东增持股份进展</p> <p>公司于 10 月 25 日披露了控股股东天水华天电子集团股份有限公司增持公司股份的计划，并在 10 月 30 日披露了控股股东追加增持金额的公告，控股股东计划总增持金额不低于 5000 万元。目前增持股份按计划进行中。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应披露的重大信息</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>